

## 車載搭載製品の軽薄短小化にも対応『M53』ペースト

M53 series solder paste that is capable of being applied to small-sized and lightweight on-board products

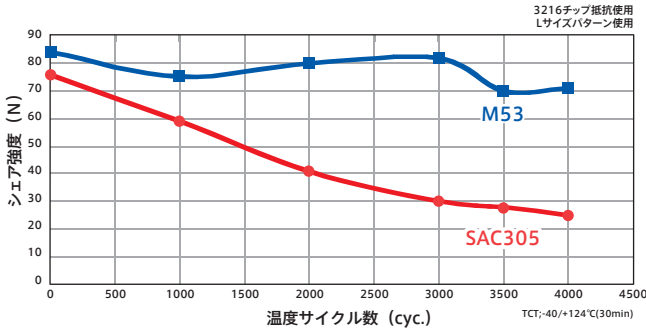
### 特長

- 耐熱疲労特性に優れ、過酷な使用条件でも高い接合強度を維持
- 熱疲労によるクラック進展を抑制、長期使用でも電気伝導を維持
- ランド面積の小さな軽薄短小化設計でも高い品質を確保



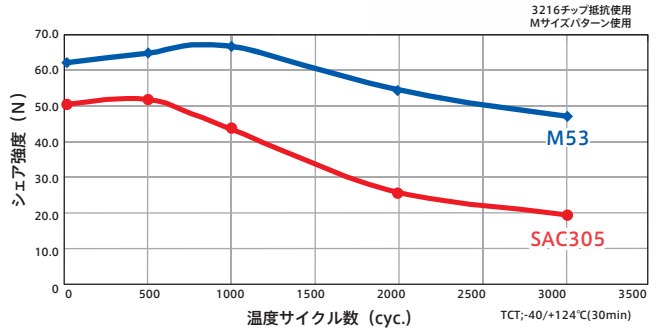
### 製品仕様

#### □ チップ抵抗での耐熱疲労特性の比較



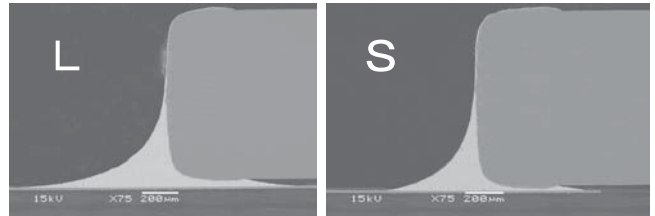
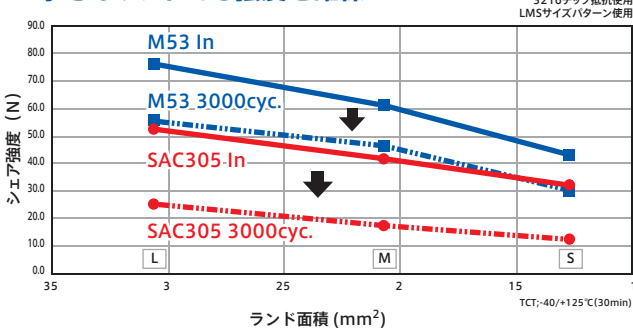
BiとInを添加したM53は、SAC305と比較し強度低下傾向が認められない

#### □ チップコンでの耐熱疲労特性の比較

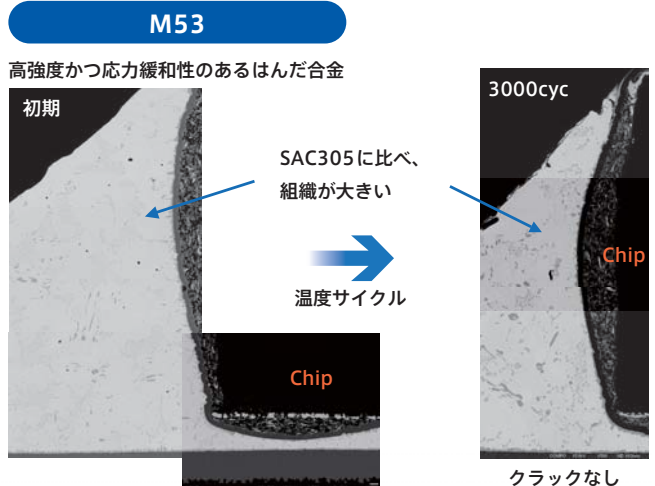
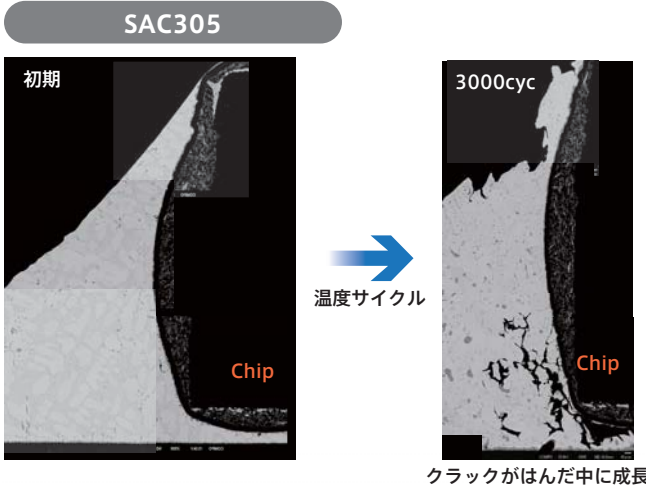


BiとInを添加したM53は、SAC305と比較して良好なシェア強度を保持

#### □ 小さなランドでも強度を確保



#### □ 断面観察写真比較



Sh-Semi12-01J